

江苏长电科技股份有限公司2015年上半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，将公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2014】874号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股股票131,436,390股，每股价格人民币9.51元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,249,960,068.90元，扣除发行费用合计人民币63,627,443.28元后，募集资金净额为人民币1,186,332,625.62元。2014年9月24日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）就募集资金到账事项出具了“苏公W【2014】B103号”《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2015年6月30日，公司已经累计使用募集资金114,367.25万元。公司募集资金专项账户存款余额为5,034.98万元（含利息）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规

范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。根据《管理制度》，公司已在中国银行股份有限公司江阴支行设立募集资金存储专户，专户账号为 481965361187，并于 2014 年 10 月 08 日与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）、中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已按相关规定公告披露。截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户存款余额为 5,034.98 万元（含利息）。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司本年度募集资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金置换先期投入自筹资金情况

经公司第五届第十次临时董事会、第五届第十一次临时董事会和 2013 年度第三次临时股东大会审议通过的《江苏长电科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

鉴于公司部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，因此，经公司第五届第二十一一次董事会审议批准，公司于 2014 年 12 月 25 日从募集资金专户中提取 78,017,595.50 元用于置换先期投入的自筹资金。公证天业对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了“苏公 W[2014]E1242 号”鉴证报告，保荐机构华英证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更情况

经公司于2015年2月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟变更募投项目之“年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”中的5.9亿元募集资金用于收购STATS ChipPAC Ltd.（以下简称“星科金朋”）股权。星科金朋是一家于新加坡交易所上市的公司，主要从事半导体封装及测试业务，是世界排名前列的半导体封装测试公司，提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体解决方案。依托现有的在倒装芯片、晶元、3D封装等方面的技术优势，为客户提供创新与成本高效的半导体解决方案。星科金朋目前在新加坡、韩国、中国上海、台湾和马来西亚拥有五个半导体封装及测试工厂和2个研发中心，同时在美国、韩国、日本、中国、新加坡、马来西亚、台湾和瑞士拥有销售团队。

鉴于星科金朋已在韩国和中国上海建有较大规模的“FC（倒装）集成电路封装测试产品”生产线，且目前产能利用率不足，公司完成对星科金朋收购之后，为了充分利用星科金朋现有相关产能，避免重复建设导致产能过剩，因此拟降低原募集资金投资项目之“年产9.5亿块FC（倒装）集成电路封装测试项目”的投资规模。

公司上述募集资金变更事项已经公司股东大会审议通过，公司监事会、独立董事均对该事项发表了明确同意意见，保荐机构华英证券亦就该事项出具了专项核查意见。

截至本专项报告披露日，有效接受要约的股份，与已经由要约人及其一致行动人持有、控制或即将收购的股份之和，占星科金朋总股本（不含要约人及其关联方或代表发出要约之前所持有的股份）的比例已超过90%。在要约期（即2015年8月27日下午5:30）期满后，本公司控股子公司JCET-SC(要约人)将根据新加坡市场相关规定，执行法定强制程序，收购剩余股权。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

江苏长电科技股份有限公司
二〇一五年八月二十六日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				124,996.01 ^{注1}		本年度投入募集资金总额			66,553.86			
报告期内变更用途的募集资金总额				59,000		已累计投入募集资金总额			114,367.25			
累计变更用途的募集资金总额				59,000								
累计变更用途的募集资金总额比例				47.20%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
年产 9.5 亿块 FC (倒装) 集成电路封装测试项目	是	84,080.00	25,080.00	25,080.00	7,553.86	20,700.84	(4,379.16)		不适用	不适用 ^{注3}	不适用	否
补充流动资金	否	35,920.00	34,666.41 ^{注2}	34,666.41	0.00	34,666.41	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
变更后投资项目												
收购新加坡星科金朋股权	是	0	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0		不适用	不适用	不适用	否
合计	—	120,000.00	118,746.41	118,746.41	66,553.86	114367.25	(4,379.16)	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“四、募集资金置换先期投入自筹资金情况”相关内容							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：募集资金总额未扣除相关的发行费用。

注 2：补充流动资金调整后投资总额与承诺投资总额存在差异主要因为实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减补充流动资金规模造成的。

注 3：截至 2015 年 6 月 30 日，公司募投项目之“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”尚处于建设期。